

Mate 2026

32nd Symposium on
 “Microjoining and Assembly Technology in Electronics”
 8-9 Dec. 2026

第32回

「エレクトロニクスにおけるマイクロ 接合・実装技術」シンポジウム

日時：2026年12月8日(火)，9日(水)
 場所：パシフィコ横浜 会議センター
 横浜市西区みなとみらい1丁目1-1

主催：
 (一社)スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会
 (一社)溶接学会 マイクロ接合研究委員会

共催：
 (一社)エレクトロニクス実装学会
 (公社)化学工学会 エレクトロニクス部会
 (一社)レーザ加工学会

協賛：
 IEEE Electronics Packaging Society (EPS) Japan Chapter,
 応用物理学会、大阪大学大学院工学研究科テクノアリーナ インキュ
 ベーション部門「つなぐ工学」、軽金属学会、精密工学会、
 電子情報通信学会、日本機械学会、日本金属学会、日本材料学会、
 日本溶接協会、日本接着学会

(依頼中を含む)

組織委員会

委員長：荏苒 郁夫 (群馬大学)
 副委員長：青柳 昌宏 (熊本大学)
 小山 真司 (群馬大学)

委員：
 石川 諭(株)東芝、岩本 知広(茨城大学)、小勝 俊巨(日本電気(株))、
 折井 晴光(Rapidus(株))、苅谷 義治(芝浦工業大学)、
 久保 雅男(大阪大学)、嶋田 勇三((一社)日本実装技術振興協会)、
 高尾 尚史((株)豊田中央研究所)、高橋 邦夫(東京科学大学)、
 高橋 良和(東北大学)、西川 英信(パナソニックホールディングス(株))、
 廣瀬 明夫(大阪大学)、藤原 伸一(株)日立ハイテク)、
 吉田 隆(富士電機(株))

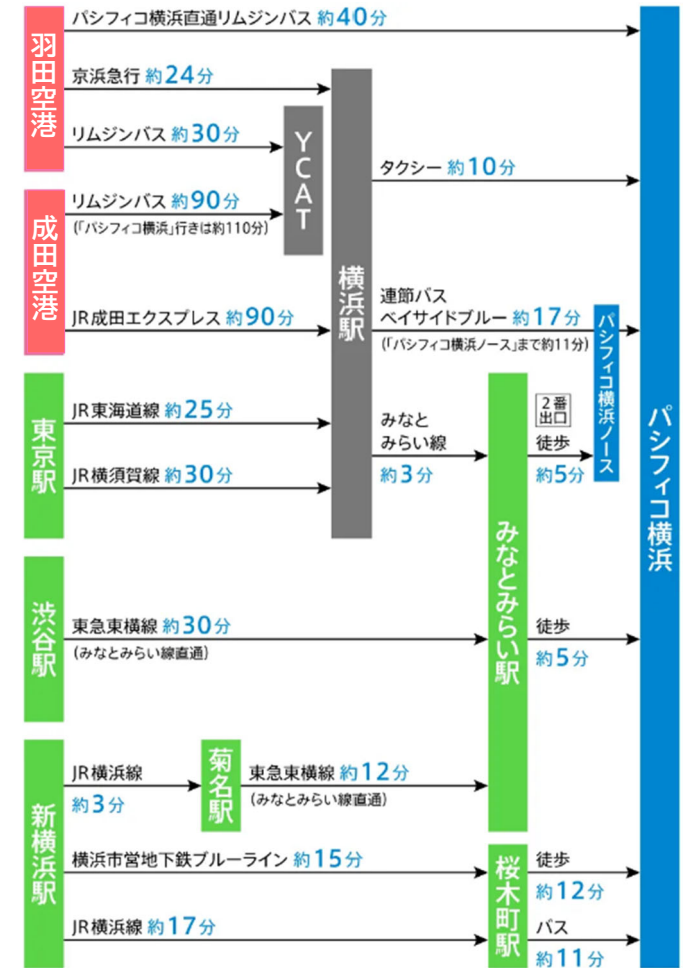
実行委員会

委員長：西川 宏 (大阪大学)
 副委員長：作山 誠樹 (Rapidus(株))
 久田 隆史 (Rapidus(株))

委員：
 青木 雄一(エスベック(株))、赤松 俊也(富士通(株))、浅井 竜彦
 (富士電機(株))、朝倉 義裕(神戸市立工業高等専門学校)、安部 元
 (三菱電機(株))、新井 進(信州大学)、荒木 徹平(大阪大学)、
 安藤 哲也(室蘭工業大学)、飯岡 諒(Western Digital Technolo-
 gies GK)、飯島 紀成((株)タムラ製作所)、池田 徹(鹿児島大学)、
 出田 吾朗(三菱電機(株))、井出 英一((株)日立製作所)、井上 雅博
 (群馬大学)、今井 健太郎(群馬大学)、岩田 剛治(大阪大学)、
 上島 稔((株)ダイセル)、上西 啓介(大阪大学)、海老原 伸明(宇宙
 航空研究開発機構)、尾形 繁行(OKIネクステック(株))、岡本 康
 寛(広島大学)、小椋 智(大阪大学)、小幡 進((株)東芝)、笠原 崇史
 (法政大学)、上川路 優(化研テック(株))、川野 崇之(サンワテク
 ニック(株))、木村 文信(東京大学)、葛谷 俊博(室蘭工業大学)、
 小金丸 正明(鹿児島大学)、小林 竜也(群馬大学)、小原 さゆり(日
 本アイ・ピー・エム(株))、阪元 智朗(オムロン(株))、櫻井 大輔
 (パナソニックホールディングス(株))、関本 隆司(日本アビオニ
 ク(株))、瀬知 啓久(東京プレイズ(株))、高岡 英清((株)村田製作
 所)、立花 芳恵(千住金属工業(株))、巽 裕章(大阪大学)、
 田中 大器(早稲田大学)、反田 耕一(ダイキン工業(株))、
 出口 和樹(奥野製薬工業(株))、富岡 泰造((株)東芝)、中田 裕輔
 (JX金属(株))、永田 英和(奥野製薬工業(株))、濱田 真行(地独)
 大阪産業技術研究所)、中丸 弥一郎((株)JCU)、林 和(群馬
 産業技術センター)、香名 博史(Astemo(株))、福本 信次(大阪大
 学)、藤田 晶(化研テック(株))、藤野 純司(三菱電機(株))、
 前田 和孝(京セラ(株))、前田 真杉(奥野製薬工業(株))、松嶋 道也
 (大阪大学)、松田 朋己(大阪大学)、松林 良(パナソニック インダ
 ストリー(株))、圓尾 弘樹(パナソニック コネクト(株))、
 見山 克己(北海道科学大学)、森内 智大(奥野製薬工業(株))、
 森 貴裕((株)ADEKA)、森 三樹(華為技術日本(株))、谷中 勇一
 ((株)レゾナック)、山内 啓(群馬工業高等専門学校)、山口 敦史
 (パナソニック インダストリー(株))、山根 常幸(東レテクノ
 (株))、山本 哲也((株)東芝)、山本 佑樹((株)弘輝)、横沢 伊裕
 (UBE(株))、若松 栄史(大阪大学)、渡辺 潤(OKIネクステック
 (株))、渡邊 裕彦(富士電機(株))

(依頼中を含む)

会場アクセス



開催主旨

日本のエレクトロニクス産業は、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられた電子デバイス・部品を組み込んだ新たな電子システム創成によって、社会の発展を牽引してきました。さらに今後、持続可能な社会を実現していくためには、技術の科学的探求をベースとしつつ、既存の学問領域や設計・生産技術などの領域を越えて、経営・生産システムや価値システムなどの広い範囲を取り込んだ最適化とそれに基づくシステムインテグレーションが不可欠になってきています。本シンポジウムは、エレクトロニクスにおける接合・実装技術をコアとした最新の生産技術に関して、研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。

論文概要申込方法

下記URLに申込みホームページを設けますので、必要事項を記入して申込みを行ってください。

<https://sps-mste.jp/mate/>

申込締切：2026年6月30日（火）

論文募集

独創性に富むオリジナル論文（学術論文、研究開発論文）を募集しております。各講演の発表時間は12分程度を予定しております。投稿希望の方はWEB申込みしていただくようお願い申し上げます。執筆要項、学術論文、研究開発論文の区分等に関しましては、論文投稿時に選択してください。

速報論文募集

最新のデータを公表できる場として、オリジナル速報論文を募集します。発表形式は口頭発表（発表時間は12分）、またはポスターセッションでの発表（20件程度）のいずれかを選択でき、前者では2ページの、後者では1ページの速報論文で申込みが可能です。WEB申込時に、希望の発表形式（口頭発表、ポスター発表のいずれか）を選択いただくようお願い申し上げます。なお、ポスター発表では、2分間のショートプレゼンテーションを実施します。

*プログラムの都合により、発表形式（口頭発表、ポスター発表）の変更をお願いする場合があります。

概要受理決定後、論文は4～6ページの論文を、速報論文は発表形式に合わせて2または1ページの論文を提出してください。なお、投稿の流れや執筆要項などの詳細はホームページを参照してください。

論文および発表の概要・締切

論文提出締切：2026年9月11日（金）

速報論文締切：2026年9月25日（金）

	種類・発表形式	ページ数
論文	学術論文	4～6ページ
	研究開発論文	
速報論文	口頭発表	2ページ
	ポスター発表	1ページ

表彰

本シンポジウムで発表された優秀なオリジナル論文に対してシンポジウム賞（優秀論文賞、奨励賞）、また速報論文および学生の発表に対して表彰制度を用意しております。

参加費（税込み、予定）

*懇親会費込み（ただし学生の参加費には懇親会費は含まれません）

*論文集PDFダウンロード付

	2026/11/20まで	11/21以降
主催団体個人会員	25,000円	30,000円
主催団体シニア会員	15,000円	20,000円
大学・国公立研究機関	25,000円	30,000円
発表者・座長	25,000円	30,000円
主催団体維持・賛助会員	30,000円	35,000円
共催団体会員	30,000円	35,000円
協賛団体会員	35,000円	40,000円
一般	40,000円	45,000円
学生	10,000円	15,000円
論文集（冊子）	5,000円	

*論文集(冊子)希望者は参加申込み時にお申込み下さい。

<問合せ先>

Mate2026事務局

<株式会社 GLEAM(グリーム) 内>

E-MAIL: mate@glm-p.com

PHONE: 06-4798-2078 FAX: 06-4798-2078

カテゴリーA 工 法

- A-1 固相接合
- A-2 ソルダリング
- A-3 ろう付
- A-4 溶接
- A-5 接着
- A-6 ナノプロセス
- A-7 成膜
- A-8 めっき
- A-9 印刷
- A-10 ビーム加工
- A-11 エッチング
- A-12 マイクロ加工
- A-13 塑性加工
- A-14 システム化・統合化
- A-15 その他

カテゴリーB 研究・開発の観点

- B-1 金属材料
- B-2 有機材料
- B-3 複合材料
- B-4 加工プロセス
- B-5 アセンブリプロセス
- B-6 メカニズム・現象解析
- B-7 接合・界面構造
- B-8 信頼性
- B-9 解析・シミュレーション
- B-10 機能設計・システム
- B-11 熱マネジメント
- B-12 設備・機器
- B-13 検査・評価
- B-14 計測・分析
- B-15 生産システム
- B-16 その他

カテゴリーC 対象形態・製品

- C-1 デバイス
- C-2 パッケージ（3D、ウェハレベル等）
- C-3 モジュール（パワー）
- C-4 モジュール（車載、光、LED等）
- C-5 MEMS・センサー
- C-6 実装部品
- C-7 基板（PCB、インターポーザ等）
- C-8 エネルギー変換機器
- C-9 車載機器
- C-10 通信・携帯機器、コンピュータ
- C-11 光学・表示機器
- C-12 医療・バイオ機器
- C-13 航空宇宙機器
- C-14 その他